

台灣電子製造設備工業同業公會 函

機關地址：110 台北市信義路五
段 5 號 3 樓 3E41 室
聯絡人：鄭雅方小姐
聯絡電話：02-27293933#37
電子郵件：bonny@teeia.org.tw

受文者：弘光科技大學

發文日期：中華民國 114 年 9 月 1 日

發文字號：設備字第 1140901074 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：半導體設備與製程技術種子教師課程種子師資培訓班議程

主旨：敬邀全國公私立大專院校教師參加「半導體設備與製程技術種子教師課程(9/23-24)」，敬請惠予公告並轉知教師踴躍報名參加。

說明：

- 一、在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由半導體產業師資培訓班，邀請半導體技術領域廠商進行分享，讓教師透過課程了解半導體產業面實際現況，期望有助於教師日後回校教學內容更貼近產業所需，導入業界人才需求之專業課程，以提升學生實務認知。
- 二、培訓對象：全國大專院校以上現職教師，預計 20 人(依各校報名先後順序安排學員)
- 三、培訓費用：免費，結業時本會將發給教師種子師資培育時數證明。
- 四、報名連結：<https://www.surveycake.com/s/4GAv6>
- 五、報名時間：即日起至 114 年 9 月 18 日，額滿為止。請各校惠予參與培訓人員公(差)假。
- 六、如有相關問題，請逕洽本案聯絡人：台灣電子製造設備工業同業公會 鄭小姐，電話：02-27293933 ext. 37

正本：公私立大專校院

台灣電子製造設備工業同業公會

理事長 林士青